

ベトナム半導体産業の現状と展望

2026年の世界半導体産業は1兆ドル規模になると予測されています。ベトナム政府は2024年以降、半導体産業を国家戦略として明確化し、2030年までの国家戦略を打ち出しました。2026年に入り、この分野でいくつか注目すべき報道がありましたので、ベトナムにおける同産業の発展史を振り返りつつご紹介したいと思います。

半導体産業は、おおまかに述べると、①設計（EDA・IP・ファブレス）→②前工程（ウェハ製造：ファウンドリ／IDM）→③後工程（組立・テスト・パッケージ：OSAT/ATP）という流れで製品が生産され、材料・製造装置・人材が各工程を横串で支えます。ベトナムでは現在、①の設計工程を担う企業が約60社（うち国内企業が10社超）、③の後工程を担う企業が約15社（うち国内企業が1～2社）となっています。

2000年以降、ルネサス（日本）など、半導体の設計工程を担う外資企業が進出し始めます。後工程を担う工場ができたのは、2006年のIntel（米国）の進出以降です。Intelはホーチミン市サイゴン・ハイテクパークで組立・テスト拠点（後工程）を拡大し、2010年に世界最大級のアSEMBリ／テスト工場として稼働しました。その後、2016年にHana Micron（韓国）が北部バクニン省に進出し、2023年に第二工場が竣工。2023年にはAmkor Technology（米国）が同じくバクニン省で16億ドル規模の大型OSAT工場を稼働させています。

このように、ベトナムの半導体産業は、まず外資による設計、後工程から始まりました。その過程で設計・人材育成を厚くしつつ、近年は国内企業による工程の内製化に踏み出す局面に入っています。2026年に入り、国内通信大手のViettelが「国内初」とされる半導体チップ製造工場の起工を発表しました。これは半導体製造の中で最も難しいとされる②前工程を担う工場、ベトナムでこの工程を担う初の工場となります。これに呼応するかたちで、国内IT大手のFPTが半導体チップの先端テスト・パッケージング工場の設立を公表しました。FPTは元々、半導体設計を手掛けており、この工場はViettelなどと連携して、ベトナム国内企業で設計～製造～テスト・パッケージングまでを完結させる国家戦略に資すると発表しています。さらに、ベトナム政府は2026年1月に「半導体国家センター」設立に関する決定を公布しました。設計から試作・検証・量産接続までを支える国内の受け皿を作り、エコシステムを自走させることを目的として、産業連携、サービス提供、研修などを担うセンターがハノイに整備される計画です。

現時点では、Viettelの工場がどのノード、どの製品領域で立ち上がるかは未知の段階です。既に厚みのある後工程の高度化、周辺の加工・サービスといった裾野を拡大しつつ、国家センターを核に人材育成と試作・連携機能を整え、外資の量産力と国内の設計・実装力を接続できるかが、ベトナムが「後工程の拠点」から「より上流に伸びる拠点」へ進む分岐点になるとみられます。

米国の相互関税措置への対応（更新情報）

2月20日、米最高裁による IEEPA（国際緊急経済権限法）に基づく関税措置を違法とする判決を受けてからの一連の流れについて、ベトナム国内ではまだ様子見の段階で早急に対応をとる動きはみられていません。

大阪産業局 ベトナムビジネスサポートデスク
株式会社 NC ネットワーク (ベトナム: NC Network Vietnam JSC.)

日本事務所：東京都台東区東上野1丁目14番5号 ユーエムビル8階

ベトナム事務所：8, No.5 Street, Him Lam, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh, VIET NAM